

สารบัญ

	หน้า
คำขอคุณ	๑
บทกตยอ	๒
Abstract	๓
รายการตารางประกอบ	๔
รายการรูปประกอบ	๘
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ทฤษฎี	๔
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการระเหยสารในสูญญากาศ	๔
2.2 โครงสร้างพลีกแบบชัลโคลไฟร์ท	๑๒
2.3 ทฤษฎีเอบพลังงานของชองแซ็ง	๑๔
2.4 สเมติกทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ	๑๘
บทที่ ๓ การสร้างอุปกรณ์	๒๑
3.1 การวางแผนอุปกรณ์ภายในกรอบแก้ว	๒๑
3.2 ระบบควบคุมการระเหยสาร ๓ จุดโดยคอมพิวเตอร์	๒๖
3.3 โปรแกรมควบคุมระบบการระเหยสาร	๓๓
3.4 การควบคุมอุณหภูมิแบบผ่อนรับ	๓๕
3.5 หม้อแปลงที่ใช้ในการระเหยสาร	๓๘
บทที่ ๔ การทดลองและผลการทดลอง	๔๐
4.1 การเตรียมอุปกรณ์ก้าแฟนฟิล์ม	๔๐
4.2 การเตรียมแฟนฟิล์ม	๔๓
4.3 การทดสอบระบบควบคุมการระเหยสาร ๓ จุดโดยคอมพิวเตอร์	๔๖
4.4 การทดสอบโครงสร้างพลีกของแฟนฟิล์ม Cu/Ir ₂	๖๕
4.5 การแยกนิลแฟนฟิล์ม	๗๐
4.6 การวัดค่าความต้านทานในช่วงต่ำกว่าอุณหภูมิแอนนิล	๗๕
4.7 ความล้มเหลวระหว่างความต้านทานและอุณหภูมิ	๗๘
4.8 การวัดกระแสและความต้านทานของแฟนฟิล์ม	๘๑
4.9 การตรวจสอบชนิดของสารกึ่งตัวนำโดยวิธี Hot probe	๘๑

	หน้า
4.10 การวัดความต้านทานของแผ่นฟิล์มและความเข้มแสงทางรังสี	84
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง ปืนหัวและข้อเสนอแนะ	89
5.1 สรุปผลระบบคุณภาพรายเดือน 3 ชุดโดยคอมพิวเตอร์	89
5.2 สรุปผลการตรวจสอบโครงสร้างผลึกของแผ่นฟิล์ม CuInSe ₂	90
5.3 สรุปผลสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์ม CuInSe ₂	91
5.4 ปืนหัวและข้อเสนอแนะ	91
เอกสารอ้างอิง	93
ภาคผนวก	95
ประวัติการศึกษา	136

จดหมายเหตุ
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

รายการสารจากประกอบ

รายการที่		หน้า
3.1	ผลติงค่าสัมบูรณ์ของหม้อแปลงแต่ละตัวที่สร้างขึ้นใช้งาน	38
4.1	ผลติงค่า $\Delta f/\Delta m_{x-ea}$ เมื่อระheyลาร ๐๖ ชั้นไปเกา คริสตอลตัวที่ ๑	48
4.2	ผลติงค่า $\Delta f/\Delta m_{x-ea}$ เมื่อระheyลาร ๐๙ ชั้นไปเกา คริสตอลตัวที่ ๒	49
4.3	ผลติงค่า $\Delta f/\Delta m_{x-ea}$ เมื่อระheyลาร ๘๖ ชั้นไปเกา คริสตอลตัวที่ ๓	49
4.4	ผลติงค่ามวลที่ร่ายheyเกาแผ่นรองรับ (๓) ทางกฤษฎี และการทดลอง เมื่อระheyลาร Cu	57
4.5	ผลติงค่ามวลที่ร่ายheyเกาแผ่นรองรับ (๓) ทางกฤษฎี และการทดลอง เมื่อระheyลาร Se	58
4.6	ผลติงค่ามวลที่ร่ายheyเกาแผ่นรองรับ (๓) ทางกฤษฎี และการทดลอง เมื่อระheyลาร Ag	59
4.7	ผลติงค่าความหนาในระยะ ๑ ต่าง ๆ เมื่อความดันเปลี่ยนไป 796 Hz.	63
4.8	ผลติงค่าความหนาในระยะ ๑ ต่าง ๆ เมื่อความดันเปลี่ยนไป 1418 Hz.	63
4.9	ผลติงค่าความหนาในระยะ ๑ ต่าง ๆ เมื่อความดันเปลี่ยนไป 2635 Hz.	64
4.10	ผลติงการเปรียบเทียบเบอร์ เทิน์ ความหนาที่ลดลงของแผ่นฟิล์ม [*] ในระยะ ๑ ต่าง ๆ เมื่อใช้คริสตอลเป็นมอนิเตอร์ และใช้ กฤษฎีแหล่งกำเนิดที่เป็นพื้นที่เล็ก ๆ	65
4.11	ผลติงแผ่นฟิล์มที่เตรียมเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผลึกคิวบิวทิ XRD.	66
4.12	ผลติงแผ่นฟิล์มที่เตรียมเพื่อศึกษาสมบัติการไฟฟ้า	72
4.13	ผลติงค่าความเข้มแสงในระยะต่าง ๆ เมื่อกำลังไฟฟ้าของ ดวงไฟ มีค่าเท่ากับ ๕๘.๙ วัตต์	85

รายการภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
2.1	แสดงการรายเหยียบจากแหล่งกำเนิดที่เป็นจุด	6
2.2	แสดงการรายเหยียบจากแหล่งกำเนิดที่เป็นพื้นที่เล็ก ๆ	8
2.3	แสดงการกระจายความหนาของฟิล์มในระยะ 1 ต่อ ๙	9
2.4	แสดงการอินทิเกรตพื้นที่ DA บนแผ่นรองรับ	11
2.5	แสดงโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไฟไวร์	13
2.6	แสดงแผนภาพระดับแกนพลังงานในผลึกที่เป็นผังกั้นของระยะห่างระหว่างอยู่ตอน	14
2.7	แสดงแผนภาพให้เห็นพื้นฐานที่แตกต่างกันของแบบผลังงาน	15
2.8	แสดงสารกึ่งตัวนำอินทริวสิก, ผู้ให้และผู้รับ	19
3.1(ก.)	แสดงรายละเอียดการวางแผนต้าหน่งอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในครองแก้ว	22
3.1(ข.)	แสดงการวางแผนต้าหน่งจุดรายเหยียบ, แผ่นรองรับและคริสตอล	23
3.2(ก.)	แสดงการวางแผนต้าหน่งจุดรายเหยียบกึ่ง ๓ จุด ที่วางสมมาตรกันบนฐานรอง.	24
3.2(ข.)	แสดงชนิดบีบห้องจุดที่ ๒ ที่ใช้ร่วมกับแผนที่ ๑ และจุดที่ ๓	25
3.3(ก.)	แสดงการวางแผนต้าหน่งคริสตอลกึ่ง ๓ จุด บนแผ่นยืดต้านบน	27
3.3(ข.)	แสดงการยกระดับคริสตอลกึ่ง ๓ จุด บนแผ่นยืดต้านบน	28
3.4	แสดงแผนผังของระบบควบคุมการรายเหยียบสาร ๓ จุด โดยคอมพิวเตอร์	29
3.5	แสดงวงจรขอสัญญาณ เลเตอร์	31
3.6	แสดงการควบคุมมุมนำกรายเสียงไทริลเตอร์	32
3.7	แสดงผังงานของโปรแกรมการควบคุมระบบ	34
3.8	แสดงผังงานของโปรแกรมเชื่อมกราฟและเก็บไฟล์	36
3.9	แสดงการติดตั้งแผ่นท้าความร้อน โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมกลมประภัยติดตั้งกับแผ่นรองรับ	37

ภาคที่		หน้า
3, 10	แสดงการต่อหม้อแปลง แต่ละตัวรับปั๊กที่ใช้ระดับสากล ทั้ง 3 ชุด	39
4.1	แสดงหน้าหากิล์ม 3 ชีน และ 7 ชีน	41
4.2	แสดงหน้าหากิล์มข้าวไฟฟ้า	42
4.3	แสดงการยัดหน้าหากิล์มกับแผ่นยึดแผ่นรองรับ	44
4.4	แสดงการวางแผนหน้าหากิล์มนวนแผ่นยึดด้านบน	45
4.5	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคริสตอล กับเวลา เมื่อกำกั้นระดับสารอย่างอิสระ โดย ไม่มีการควบคุม	51
4.6	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนความถี่ ของคริสตอลกับเวลา เมื่อกำกั้นระดับสารอย่างอิสระ โดยไม่มีการควบคุม	52
4.7	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคริสตอล กับเวลา เมื่อกำกั้นระดับสารภายใต้การควบคุม โดยคอมพิวเตอร์	53
4.8	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเปลี่ยนความถี่ ของคริสตอลกับเวลา เมื่อกำกั้นระดับสารเปลี่ยน ความถี่เท่ากับ $40 \text{ Hz.}/10 \text{ sec.}$ หรือ $4 \text{ Hz.}/\text{sec.}$	54
4.9	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มวลที่รั่วหายเกา แผ่นรองรับกับมวลทึบหมุดที่ใช้ระดับสากล ทางทฤษฎี และการทดลอง เมื่อรั่วหายสาร O_2	60
4.10	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มวลที่รั่วหายเกา แผ่นรองรับกับมวลทึบหมุดที่ใช้ระดับสากล ทางทฤษฎี และการทดลอง เมื่อรั่วหายสาร S_6	61
4.11	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มวลที่รั่วหายเกา แผ่นรองรับกับมวลทึบหมุดที่ใช้ระดับสากล ทางทฤษฎี และการทดลอง เมื่อรั่วหายสาร I_2	62

การที่	หน้า
4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์ความหนา กับระยะ 1 ต่าง ๆ เมื่อกำกั่วลดโดยใช้คริสตอล เป็นอนีเตอร์ และใช้กอญวีแอลังก้าเนิดการรายเหย สารที่เป็นพื้นที่เล็ก ๆ	67
4.13 ทดสอบการเปรียบเทียบ เส้นการเลี้ยวเบนของผลึก CuInSe ₂ แบบแรกกับแบบพิล์มนบางของแผ่นพิล์มที่ 3	68
4.14 ทดสอบการเปรียบเทียบ เส้นการเลี้ยวเบนของผลึก CuInSe ₂ แบบแรกกับแบบพิล์มนบางของแผ่นพิล์มที่ 4	69
4.15 ทดสอบเคาน์เตอร์เล็ก เพื่อใช้สอนนิลแผ่นพิล์ม ในระบบสุญญาการ	71
4.16 ทดสอบการต่อชั้วไฟฟ้า โดยการใช้การเงิน	71
4.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ $10^3/T(K^{-1})$ ขณะสอนนิลแผ่นพิล์มที่อุณหภูมิ 350°C. เป็นเวลา 1(1/2) ชั่วโมง	73
4.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ $10^3/T(K^{-1})$ ขณะสอนนิลแผ่นพิล์มที่อุณหภูมิ 400°C. เป็นเวลา 1(1/2) ชั่วโมง	74
4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ $10^3/T(K^{-1})$ เมื่อแผ่นพิล์มผ่านการแอนนิลที่อุณหภูมิ 350°C. เป็นเวลา 1(1/2) ชั่วโมง	76
4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ $10^3/T(K^{-1})$ เมื่อแผ่นพิล์มผ่านการแอนนิลที่อุณหภูมิ 400°C. เป็นเวลา 1(1/2) ชั่วโมง	77
4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า กับความต่างศักย์ ที่อุณหภูมิห้องของแผ่นพิล์มที่ 5	82
4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า กับความต่างศักย์ ที่อุณหภูมิห้องของแผ่นพิล์มที่ 6	83
4.23 ทดสอบชุดวัดความต้านทานและความเริ่มแสง	85

ภาคที่		หน้า
4.24	กราฟแสดงความลับมันธ์รายหัวของความเข้มแผลผลกระทบ กับความต้านทานที่เปลี่ยนไปของแผ่นพิมพ์	87
ผ.อ.5 (ก)	รูปแสดงตัวແນ່ງຊุ一刻 เหยยສารັ້ງ 3 ຊຸດ ພນສານຮອງ	133
ผ.อ.5 (ຂ)	รูปแสดงระบบควบคุมการระบายเสียงໂຄຍຄອມພິວເຕອົວ	133
ผ.อ.6	รูปแสดงหล่อແບລອກໃຫຍ່ເຫຍສາຣ	134
ผ.อ.7	รูปแสดงหน้ากาภີສົມ	134
ผ.อ.8	รูปแสดงແຜ່ພິສົມທີ່ເຕີຍມໄຕ້ແລະຝ່ານກາທຳຂຶ້ນແລ້ວ	135

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved